PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-169971

(43)Date of publication of application: 30.06.1997

(51)Int.CI.

CO9K 3/14

B01J 3/06

B24D 3/00

CO1B 21/064

(21)Application number: 07-348603

(71)Applicant: SHOWA DENKO KK

(22)Date of filing:

18.12.1995 (72)

(72)Inventor: SUGANO KATSUO

KASAHARA MAKOTO

OKUBO TAKUYA

MAKI MASAKAZU

(54) CUBIC BORON NITRIDE ABRASIVE GRAIN AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject abrasive grain useful as a grinding abrasive grain, a whetstone, coated abrasive, etc., having a specific relatively low bulk specific gravity prescribed as a particle size distribution and a prescribed relatively high toughness value, continuing

a₂ ≦ かさ比重 ≦ a₁

excellent cutting quality.

SOLUTION: This abrasive grain has a particle size distribution based on a regulation of JIS-B4130, belonging to #325/400 to #60/80 and satisfies relative equations, equation 1 (a1=2.581!×10-9 χ 3-2.894×10-7 χ 2-9.491×10-4 χ +1.892; a2=4.316×10-9 χ 3-1.662×10-6 χ 2-5.992×10-4 χ +1.714) and equation II (3.245×10-6 χ 3-2.566×10-3 χ 2+7.125×10-1 χ +9. 264; b2=3.245×10-6 χ 3-2.556×10-3 χ 2+7.125×10-1 χ -6.736) when the maximum particle size (the minimum value) of each fraction of particle size is χ 4 raw

b₂ ≤ タフネス ≤ b₁

size (the minimum value) of each fraction of particle size is χ . A raw material mixture obtained by mixing hexagonal boron nitride with a catalyst for synthesizing cubic boron nitride is further blended with 5–50vol.% of a component inert to a cubic boron nitride synthesis and retained at a high

temperature under pressure to give the objective abrasive grain.

П

Ī

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.11.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

. Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)·

(12) 公開特許公報 (A)

(川)特許出願公開發号

特開平9-169971

(43)公開日 平成9年(1997)6月30日

(51) Int.CL*	線別配号	庁内整理番号	ΡI			技術表示箇所
C09K 3/14	5 5 0		C09K	3/14	5501	
B01J 3/06			B01J	3/06	7	r
B 2 4 D 3/00	320		B24D	3/00	320/	A
C01B 21/06	1		C01B 2	1/064	y	A
	•		審查請求	水筋床	商泉項の数4	FD (全 9 四)
(21)出顧番号	特顧平7-348603		(71)出廢人		104 工株式会社	
(22)出版日	平成7年(1995)12	5 188			整区艺大門1TE	313番9号
	•		(72) 郵明者	世野!	勝男	
				長野県	值民市大字家賀:	昭和電工株式会
				礼塩尻	工場内	
			(72) 発明者	強 膜	真	
				長時頃	鱼 界市大字 永 費	图和電工模式会
				社설用	工場内	
			(72) 発明者	大久保	車低	
				長野県	塩尻水大字宗賀 1	L 昭和電工株式会
				社塩尻	工場内	
			(74)代理人	护理士	内田 幸男	
						最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 立方晶室化ほう赤砥粒およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 肉質が緻密透明であり、形状がシャープで、 研削砥粒として用いたときの切れ味が良く、寿命が長い 立方晶窒化ほう素砥粒を提供する。

【解決手段】 JIS-B4130に基づく粒度分布が325/400~60/80の範圍に廃し、且つ、所定の低いかさ比重ねよび所定の高いタフネスを有する立方晶室化ほう素砥粒。この砥粒は、六方晶窒化ほう素粒子に触媒および不活性化合物を配合した原料複合物を高温高圧処理して調製される。

【特許請求の範囲】

【語求項1】 低かさ比重で高タフネス値を有する立方 晶室化ほう素の砥粒であって、JIS-B4130の規 定に基づく粒度の分布が#325/400~#60/8 0の範囲に属し、且つ、同規定に基づく粒度の各区分の 最大粒度(最小数値)を変とするとき、かさ比重および タフネスがそれぞれ下記式(1) および(2):

1

 $a_{2} \le$ かさ比重 \le a_{3} (1) $b_{2} \le$ タフネス \le b_{3} (2)

(但し、a,=2.581×10⁻¹x¹-2.894×1 10 し、さきに特許出願を行った(特闘平2-3593 0⁻¹x¹-9.491×10⁻¹x+1.892 1)。特闘平2-35931号に記載される方法に a₂=4.316×10⁻¹x¹-1.662×10⁻¹x¹ 製造されるcBN粒子は、高いかさ比重と高いタフ

-5. $992 \times 10^{-1} x + 1$. 714 $b_1 = 3$. $245 \times 10^{-1} x^3 - 2$. $566 \times 10^{-1} x^4$

 $+7. 125 \times 10^{-1} \chi + 9. 264$

 $b_2 = 3.245 \times 10^{-6} \chi^3 - 2.566 \times 10^{-3} \chi^4 + 7.125 \times 10^{-3} \chi - 6.736$

を満足することを特徴とする立方晶室化ほう素砥粒。

【語求項2】 六方晶室化はう素に立方晶室化はう素合成用触媒を配合した原料混合物を高温高圧下に保持する 20 ことによって立方晶窒化はう素配粒を合成する方法において、該原料混合物中にさらに5~5 0 容置%の立方晶窒化はう素合成に不活性な成分を配合した原料混合物を用いることを特徴とする語求項1記載の立方晶窒化ほう素砥粒を製造する方法。

【請求項3】 請求項1記載の立方晶室化ほう素砥粒からなる研削砥石。

【語求項4】 研磨材として請求項1記載の立方晶窒化 ほう素砥粒を含んでなる研磨布紙。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、低かさ比重で高タフネス値を有する立方晶室化はう素の砥粒、その製造方法、そのような砥粒からなる研削配石、およびそのような砥粒を研磨符として含む研磨布紙に関する。

[0002]

【従来の技術】立方晶盤化はう素(以下、cBNと略称する)をcBNの熱力学安定条件である高温高圧で処理することにより製造される。cBN粒子はダイヤモンドに次ぐ40 硬さを有し、しかも、化学的安定性、特に鉄系被削材に対する安定性がダイヤモンドより優れているため、砥石、研磨布紙などの研削砥粒として使用されている。【0003】cBN粒子の製法に関しては、特開昭59-57905号、特開昭59-73410号、特開昭59-73411号を含め、多くの提案がなされており、これらの一般的製法により得られるcBN粒子は上記のように優れた硬さと化学的安定性を保有している。しかしながら、これらのcBN粒子は通常の電君砥石あるいはメタルボンド砥石に使用するには問題ないが、切れ等50

が要求される研削配粒用途には適しているとは言えない。切れ味が要求される研削配粒に使用されるcBN粒子は低かさ比重すなわち形状がシャープであり、且つ、cBNの肉質としては緻密であることが望まれる。

2

【0004】本出類人は、形状がシャープで且つ内質が比較的緻密なでBN粒子を提供することを目的として検討を重ねた結果、ABNに、C額、Si額および水素化アルカリ、水素化アルカリ土類またはその他のでBN合成触媒を加えた反応系を高温高圧処理する製法を見出し、さきに特許出類を行った(特関平2-35931)。特関平2-35931号に記載される方法により製造されるでBN粒子は、高いかさ比重と高いタフネスを有しており、総密で透明であり鋭いエッジを有しており、都密で透明であり鋭いエッジを有しており、都密で透明であり鋭いエッジを有しており、都密で透明であり鋭いエッジを有しており、研削砥石に用いたとき良好な切れ味を示すが、研削を維続していくと、エッジが丸くなり、切れ味が純化していくことがわかった。

【0005】また、形状がシャープなcBN粒子を得る 別法として、特開昭51-37897号には、NBNと cBN台成用触媒とを粉末混合せずに、粉末の成形物ま たは予め焼結体を相互に接触させ、cBNの合成に適す る温度、圧力の条件下で処理することにより、細長いc BN粒子を製造する方法が記載されている。この方法に よれば、hBNスリーブと触媒コアを配置し、加圧した 際にNBNスリーブに亀裂を生じ、匍匐し鮭媒が溶解し たときにその無穀部に溶解触媒が入り込み、結果とし て、細長いcBN粒子が得られると能定される。しかし ながら、加圧時に1987スリーブに亀裂が生じても通常 c B N粒子を合成する際に必要な5GPaの圧力を掛け 30 れば、一たん生じた亀裂は、亀裂が生じなかった部分と 同じように圧縮され、溶融触媒が優先的に入り込むこと は難しいと考えられる。また、この方法ではhBN部と 触媒部を分けて配置するため変換量が少なく工業的に不 利である。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記のような従来の技術の問題点を改良して、肉質が緻密透明であり、形状がシャープ、すなわち、かさ比重が低く、従って、研削砥粒として用いたときの切れ味が良く、しかも、研削負荷が小さくかつ切れ刃が減って抵抗が大きくなったときに自生発刃を起こし、新しい切れ刃が出現し、良好な切れ味が持続すると言う特性を有し、研削砥粒として有用なcBN砥粒を提供することにある。

【①①①7】さらに、本発明の他の目的は、そのような 砥粒の工業的有利な製造方法、そのような砥粒からなる 研削砥石、および研磨材としてそのような砥粒を有する 研磨布紙を提供することにある。

[8000]

) 【課題を解決するための手段】本発明によれば、低かさ

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSAPITMP/web144/20041125000049646582.gif&N... 11/24/2004

比重で高タフネス値を有する立方晶窒化ほう素の砥粒であって、JiS-B4130の規定に基づく粒度の分布が#325/400~#60/80の範囲に属し、且つ、同規定に基づく粒度の各区分の最大粒度(最小数値)をととするとき、かさ比重およびタフネスがそれぞれ下記式(1)および(2):

 $a_z \leq$ かさ比点 \leq a_z (1) $b_z \leq$ タフネス \leq b_z (2) (但し、 $a_z = 2.581 \times 10^{-7} x^3 - 2.894 \times 10^{-7} x^4 - 9.491 \times 10^{-7} x^4 - 1.892$ $a_z = 4.316 \times 10^{-7} x^3 - 1.662 \times 10^{-7} x^4 - 5.992 \times 10^{-7} x + 1.714$ $b_1 = 3.245 \times 10^{-7} x^3 - 2.566 \times 10^{-7} x^4 + 7.125 \times 10^{-1} x + 9.264$ $b_z = 3.245 \times 10^{-7} x^3 - 2.566 \times 10^{-7} x^4 + 7.125 \times 10^{-1} x - 6.736)$ を満足することを特徴とする立方品室化ほう素砥粒が提供される。

【①①①9】さらに、本発明によれば、六方晶室化ほう 素に立方晶窒化ほう素合成用触媒を配合した原料混合物 を高温高圧下に保持することによって立方晶窒化ほう素 砥粒を合成する方法において、該原料混合物中にさらに 5~90容置%の立方晶窒化ほう素合成に不活性な成分 を配合した原料混合物を用いることを特徴とする上記立 方晶窒化ほう素砥粒を製造する方法が提供される。 【①①10】さらに、本発明によれば、上記のような c BN砥粒からなる研削砥粒が提供される。さらに、本発明によれば、上記のような c BN砥粒を研磨材として含む研磨布紙が提供される。

[0011]

【発明の食施の形態】本発明の c B N 紙粒は、その粒度分布の関数として規定される比較的低い特定のかさ比重と比較的高い特定のタフネス値を有することを特徴としている。すなわち、本発明の c B N 紙 粒 は、J I S - B 4 1 3 0 の規定に基づく粒度の分布が # 3 2 5 / 4 0 0 ~ # 6 0 / 8 0 の範囲に関し、且つ。同規定に基づく粒度の各区分の最大粒度(最小数値)を 2 とするとき、かさ比重およびタフネスがそれぞれ前記(1)および(2)によって規定される範囲に入ることを特徴としている。

【0012】JIS-B4130には、cBN粒子の粒度の区分とそれぞれの粒度区分に属する粒子の粒度分布特性(特定のエレクトロフォームふるいを用いて粒度試験によって決まる)について下記表1のとおり規定されている(但し、粒度の区分については、本類発明に関連する粒度区分#325/400~#60/80の範囲についてのみ表1に掲記した。)

[0013]

【表1】

	5											5
4段目のふるい	2 %以上回過し てはならないふ るい	ໝ <i>ಗ</i>	127	101	0.6	7.5	6.5	5.7	61	11	•	•
.	通過して もよい最 大の <u></u>	Ж	æ	10	19	10	11	11	11	11	15	15
段目のふる	とどまら めないあ	%	80	87	8.7	8 8	8.5	8.5	8.5	0.5	8.0	98 .
8	一部 なければな るいかよばな	mπ	181	151	127	107	96	7.5	65	J 2	67	41
4511	といるまる	*	80	10	10	1.0	11	11	11	11	1.5	91
2段目の	ーに てはでけない できる のを	m #	271	181	165	139	116	9.7	98	15 -	85	57
1段目のふるい	99.9%通過しなけた気があるない。	w #	364	27.1	227	197	165	139	116	8 2 8	8.5	7.5
5-B4180	役後を変える。 のできている。 では、		69/89	80/100	100/120	120/140	140/170	170/200	200/330	230/370	270/325	\$25/400

上記粒度の各区分の最大粒度(最小数値)を χ とする。例えば、#60/80の粒度区分では χ =60,#140/170の粒度区分では χ =140,#325/4000粒度区分では χ =325である。

【9914】本発明のcBN砥粒は、その各粒度区分の 粒度々に対応して、かさ比重およびタフネスがそれぞれ 下記式(1)および(2)を満足している。

 $b_{s} \leq g \gamma \lambda \lambda \leq b$, (2)

例えば、c B N 砥粒の試料の粒度分布が粒度区分#14 0/170~#100/120の範囲に亘っているとき は、この範囲内の全ての位度区分(合計3つの位度区分)のそれぞれに属する位子が上記式(1)および(2)を満足している。

【0015】本発明のcBN配粒のかさ比重は一般に使用されているcBN配粒より低く、また、タフネスも一般に使用されているcBN配粒より概して低い。上記式(1) および(2) によって規定される本発明のcBN配粒のかさ比重およびタフネスの許容範囲を一般に使用されているcBN配粒のかさ比重およびタフネスとともに数値として示すと下記表2のとおりである。

50 [0016]

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSAPITMP/web144/20041125000124844456.gif&N... 11/24/2004

8

【表2】

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· .		
粒 度区分	物性項目	本発明の cBN概粒	特別平2-36931に記載 されているcBN砥粒
60/80	かさ比強	1.81~1.69	1.94~1.84
80780	タフネス値	41~29	54~44
DA (100	かさ比重	1.80~1.68	1.93~1.83
80/100	タフネス値	50~38	63~53
100/100	かさ比重	1.78~1.65	1.91~1.81
100/120	タフネス値	56~44	69~59
100/110	かさ比重	1.761.65	1.80~1.80
120/140	タフネス値	62~50	75~65
140/190	かさ比電	1.74~1.63	1.88~1.78
140/170	タフネス値	66~54	79~69
170/100	かさ比重	1.71~1.60	1.87~1.77
170/100	タフネス値	69~57	82~72
900/190	かさ比重	1.69~1.58	1.85~1.75
200/230	タフキス値	78~61	85~75
937 / 930	かさ比重	1.67~1.56	1.84~1.74
230/270	タフネス値	75~63	88~18
270/325	かさ比重	1.85~1754	1.83~1.73
470/343	タフネス値	77~85	90~80
00 E / 4 A E	かさ比重	1.82~1.51	1.81~1.71
825/406	タフネス値	79~67	92~82

【0017】 ここで、「かさ比重」は、JIS-R61 26「入造研削材のかさ比重試験方法」のうち、試料採 取量を20.0±0.1g.シリンダー容績を8.0± O. 10m!. 落下距離を95.0±1.0mmとした 測定方法により求められる。また、「タフネス」は、粒 度により指定された餘綱で範別した試量の一定量と銅球 1個を、容績2m!のカブセルに入れて、一定時間(3 (). ()±(). (3秒) 粉砕した後、指定された篩網で篩削 し、甾綱上の試料残存重量百分率で表したものである。 【①①18】cBN砥粒のかさ比重が上記許容範囲を超 えて大きくなると、すなわち、粒子形状がブロッキーに なると砥粒の切れ味が悪くなる。上記かさ比重許容範囲 の下限は研削性能、特に高研削比を維持するのに必要な 要件であって、かさ比重が許容限界より低いと偏平状な いし針状のような異形状粒の割合が多くなって、研創性 能、特に研削比が低下する。

【りり19】タフネスは砥粒の形状に依存するところが多いものの、各位度におけるタフネスの上限は、切れ時を持続させるために砥粒切刃の自生発刃を起こすのに必要な強さであって、タフネスが許容限界を超えて大きくなると自生発刃作用が起こり難くなって、切れ味が低する。一方、各位度区分におけるタフネスの下限は自生発刃を適性に維持させるために必要な最低の強度であって、このタフネス許容下限より低くなると、砥粒の破損が早くなって研削性能、特に研削比が低下する。

【0020】本発明において目的とされる切れ味が良く 且つ長寿命の砥粒は、その粒度分布が上記所定の簡留に あって、且つ、各粒度区分における粒子のかさ比重とタ フネスがそれぞれ上記式(1)および(2)を満足する 場合にはじめて得られる。

【0021】本願発明のcBN配粒は、意法に従って、 50 hBNを高温高圧条件下におく方法において、hBNに

19

c B N 合成用触媒を配合した出発混合物中に、さらに、例えばアルミナのようなc B N 合成に不活性な成分を添加することによって得ることができる。すなわち、c B N 合成の試料空間に、h B N および c B N 合成用触媒の他に、c B N 合成に不活性なアルミナのような成分を添加しておくと、高温高圧下に生成した c B N 粒子が成長する過程で、粒子が不活性成分に接触するとそれ以上その方向には成長せず、その結果、形状がシャープな c B N 粒子が得られる。

【0022】 18Nとしては通常市販されている純度が 98%以上のものを使用することができる。 c B N 合成 **用触媒としては(1)Liなどのアルカリ金属。これら** の窒化物(Li,Nなど)、復窒化物(Li,BN,な ど) (2) Ca. Sr. Mg、Baなどのアルカリ土領 金属。これらの窒化物(Ca,N,、Sr,N,、Mg 』N、 Ba』N、など)、 複窒化物 (Ca』B。N。、Sr, B₂N₄、M₆,B₂N₄、B₈,B₃N₄など) (3) アルカ リとアルカリ土類金属の複合窒化物(LICABN、 LiBaBN、など)を使用することができる。これら のc BN合成用触媒のなかでは、触媒の安定性がよく、 且つ緻密で透明な成長層が容易に得られる点で(3)ア ルカリとアルカリ土類金属の複合窒化物が好ましい。 【0023】cBN合成用触媒の使用量はhBN100 重量部に対して5~50重量部が好ましい。cBN合成 に不活性な成分としては、cBN合成域の高温高圧下に 相転位や分解をすることがなく、且つcBN合成用触媒 と反応しない物質が用いられ、その具体例としては酸化 アルミニウム、酸化ジルコニウム、ムライト、炭化ケイ 素はどが挙げられる。価格、入手し易さなどを考慮する に限定されることはないが、基本的には粒状物が用いる れ、その許容位度範囲は一般に5~5、000µm程度 である。

【0024】cBN合成に不活性な成分の使用量は、試料空間の5~50容質%である。使用量が5容量%未満であると形状シャープ化の効果が小さい。また、50容質%を越えるとcBNの変換質が減るため工業的に不利となる。hBNにcBN合成用触媒と上記不活性成分を配合した原料混合物を高温高圧処理する際の条件は、従来と同様でよく、一般に、圧力4~6GPa、温度1、400~1、600℃、時間5分~10時間の範囲で適置返択される。最も好ましい条件は圧力約5GPa、温度約1、450℃、時間約15分である。

【10025】本発明のcBN配粒は前述のように研削配粒として有用である。より具体的には砥石(ビトリファイド、電者およびメタルボンド)および研磨布紙などが挙げられる。また、cBN粒子の表面に主にニッケル、コバルトなどの金属を被覆せしめてレジノイド砥石として用いることもできる。

cBN粒子

*【0026】 【実施例】

> 【0027】以下、実施側について本発明をより具体的 に説明する。

実施例1 (砥粒の調製)

トBN(昭和電工(株)製UHP-1、平均校径8~1 0μm、純度98%)100宣置部にcBN合成触媒と してしてABN、10重量部および酸化アルミニウム (昭和電工(株)製WA#180)を試料空間の20容 置%になるよう添加し、試料を成形した。試料を5GP a. 1500℃で高圧高温処理することにより黄色透明 なcBN粒子を得ることができた。得られたcBN粒子 を処理し、JIS-B4130粒度区分80/100お よび230/270に粒度を調整した。各粒度区分の粒 子のかさ比重及びタフネスは下記のとおりであった。

 拉度区分
 かさ比重
 タフネス

 80/100
 1.74
 42

 230/270
 1.62
 73

 【0028】比較例1 (砥粒の調製)

5 酸化アルミニウムを添加しなかった他は実施例1と同じ 方法でcBN粒子を得た。得られたcBN粒子の粒度区 分およびそれぞれの粒度区分の粒子のかさ比重およびタフネスは下記のとおりであった。

 粒度区分
 かさ比重
 タフネス

 80/100
 1.88
 45

 230/270
 1.78
 78

 【0029】比較例2(磁粒の調製)

アルミニウム、酸化ジルコニウム、ムライト、炭化ケイ 圧力6.5GPa、温度1650℃で高圧、高温処理し 素はどが挙げられる。価格、入手し易さなどを考慮する た他は比較例1と同じ方法ででBN粒子を得た。得られ と酸化アルミニウムが好ましい。不活性成分の形態は特 30 たでBN粒子の粒度区分およびそれぞれの粒度区分の粒 に限定されることはないが、基本的には粒状物が用いら 子のかさ比重およびタフネスは下記のとおりであった。 http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSAPITMP/web144/20041125000139842294.gif&N.. 11/24/2004

<u> 拉度区分 かさ比重 タフネス</u> 80/100 1.90 34 230/270 1.72 60

【0030】比較例3 (砥粒の調製)

実施例1で得られたcBN粒子を形状分離機にかけて、 さらにシャープな形状を有する粒子を梟中的に採取した。得られたcBN粒子の粒度区分およびそれぞれの粒 度区分の粒子のかさ比重およびタフネスは下記のとおり 40 であった。

粒度区分かさ比重タフネス80/1001.6331230/2701.5158

【①031】実施例2(低石セグメントの作成) 実施例1で得られたでBN砥粒(粒度80/100、か さ比重1.74、タフネス42)を用い、下記配合処方 によって複合物を調製し、150℃で加圧成形後、95 ①℃で本焼成して砥石セグメントを作成した。 焼成後の 砥石セグメントの気孔率は30容置%であった。

50容置%

ホウ硅酸系ピトリファイドボンド

フェノール樹脂

20容置%

10容置%

【0032】実能例3(砥石セグメントの作成) 実施例1で得られたcBN砥粒(粒度230/270、 かさ比重1.62、タフネス73)を用い、下記配台処*

*方によって混合物を調製し、150℃で加圧成形後、9 50°Cで本焼成して砥石セグメントを作成した。 徳成後 の砥石セグメントの気孔率は30容量%であった。

cBN粒子

50容置%

ホウ硅酸系ピトリファイドボンド

20容置%

フェノール樹脂

10容置%

【0033】比較例4(砥石セグメントの作成) さ比重1.88.タフネス45)を用い、下記配合処方※

※によって混合物を調製し、150℃で加圧成形後、95 比較例1で得られたcBN砥粒(粒度80/100、か 16 0℃で本焼成して砥石セグメントを作成した。 遠成後の 砥石セグメントの気孔率は30容量%であった。

cBN粒子

50容置%

ホウ硅酸系ピトリファイドボンド

20容置%

フェノール樹脂

10容置%

【()()34】比較例5(砥石セグメントの作成) 比較例2で得られた粒度80/100.かさ比重1.9 Oおよびタフネス34を育するcBN砥粒を用い、下記 配合処方によって混合物を調製し、150°Cで加圧成形★ ★後、950℃で本焼成して研削砥石セグメントを作成し た。焼成後の砥石セグメントの気孔率は30容量%であ った。

cBN粒子

5 () 容置%

ホウ硅酸系ピトリファイドボンド

20容置%

フェノール樹脂

10容置%

【① 035】比較例6(砥石セグメントの作成) 比較例3で得られた粒度80/100,かさ比重1.6 3およびタフネス31を有するcBN砥粒を用い、下記 配合処方によって混合物を調製し、150℃で加圧成形金

☆後、950℃で本焼成して研削砥石セグメントを作成し た。競成後の砥石セグメントの気孔率は30容量%であ った。

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSAPITMP/web144/20041125000158414378.gif&N... 11/24/2004

cBN粒子

50容置%

ホウ硅酸系ピトリファイドボンド

20容置%

フェノール樹脂

10容置%

【0036】比較例7(砥石セグメントの作成) 比較例1で得られたcBN砥粒(粒度230/270、 かさ比重1.78、タフネス78)を用い、下記配台処◆

◆方によって混合物を調製し、150°Cで加圧成形後、9 30 50℃で本焼成して研削砥石セグメントを作成した。焼 成後の砥石セグメントの気孔率は30容置%であった。

cBN粒子

50容置%

ホウ硅酸系ピトリファイドボンド

20容置%

フェノール樹脂

10容置%

【①①37】比較例8(砥石セグメントの作成) 比較例2で得られた粒度230/270、かさ比重1. 72. タフネス60を有するc BN砥粒を用い、下記配 合処方によって混合物を調製し、150℃で加圧成形 * *後、950℃で本焼成して砥石セグメントを作成した。 焼成後の砥石セグメントの気孔率は30容置%であっ 12.

cBN粒子

50容置%

ホウ硅酸系ピトリファイドボンド

20容置%

フェノール樹脂

10容置%

【①①38】比較例9(砥石セグメントの作成) 比較例3で得られた粒度230/270、かさ比重1. 51. タフネス58を有するcBN砥粒を用い、下記配 台処方によって混合物を調製し、150℃で加圧成形 ※ ※後、950℃で本焼成して砥石セグメントを作成した。 焼成後の砥石セグメントの気孔率は30容置%であっ tc.

cBN粒子

5) 容置%

ホウ硅酸系ピトリファイドボンド

20容置%

フェノール樹脂

110容置%

【①①39】研削砥石の作成および研削試験

た砥石セグメントを、倉法に従ってアルミ台金に接着し 上記実施例2および3、ならびに比較例4~9で作成し 50 で砥石化した後に、以下の条件で研削試験を行った。

砥石:、14A1形、150°×125'×15'×5°×3*×76.2"

研削盤: 満軸平面研削盤(砥石輪モーター 3.7 K W)

綾削村: SKI!-51. (HRC 62~64)、綾研削面200mm長×

100mm幅

研削方式: 温式平面トラバース研削方式

研削条件: 砥石国速度 1800m/min テーブル速度 15m/min

クロス送り 2mm/pass、切込み20.30um

研削液: JIS W2種 cBN専用液、50倍液、9 !/min

研削結果を表3~表6に示す。

*【表3】

[0040]

*19

競度80/100、切込み20μmのとき

種類	実施例2	近較例4	比較例5	比較例6
研削比	937	935	873	620
研削動力(質)	1330	1810	2000	1980
面 平行方向趾(μα)	0.27	0.28	0.25	0.25
面 平行方向路(μα) 直角方向路(μα)	9.89	0.93	0.87	0.87

[0041]

※ ※【表4】 粒度80/100、切込み30μmのとき

種	類	実施例2	比較例4	比較例5	比較例6	
研	削比	658	674	628	550	
研問	(脚力(Y)	1690	2170	2250	. 2280	
Œ.	平行方向Ba(μn)	0.28	0.28	0.27	. 0.27	
の配面	直角方向Ba(μη)	1,32	1.25	1.30	1.35	

10042]

類 類	実施例3	比較例?	比較例8	比較例の
研削此	2411	2358	2085	1990
研削動力(物)	580	710	810	820
面 平行方向Ba(#A)	0.18	0.19	0.18	0.18
面 平行方向配(μn) 祖 さ 直角方向版(μn)	0.75	0.76	0.68	0.75

[0043]

☆ ☆【表6】 粒度230/270、切込→30μmのとき

	種	類	実施例3	比較例?	比較例8	此級到9
ſ	拼	削比	929	945	303	827
Ī	ΨĤ	川動力(約	670	940	1010	1980
Ī	画	平行方向险(μm)	0.21	0.22	0.20	0.21
l	面担き	直角方向Re(gra)	1.70	1.8?	1.61	1.55

[0044]

【発明の効果】本発明のcBN砥粒は、肉質が緻密透明であり、形状がシャープ。すなわち、かさ比重が低く、従って、研削砥粒として用いたときの切れ場が良く。しかも、研削負荷が小さくかつ切れ刃が減って抵抗が大き

くなったときに自生発刃を起こし、新しい切れ刃が出現 し、良好な切れ味が持続すると言う特性を有する。従っ て、このでBN砥粒は、研削配粒に好適であって、砥石 および研磨布紙などとして有用である。 (72) 発明者 牧 昌和 長野県塩尻市大字宗賀1 昭和電工株式会 社塩尻工場内 ttp://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSAPITMP/web144/20041125000230479980.gif&N... 11/24/2004